WCG700-ZJS
单晶硅棒切磨复合加工一体机
Silicon Ingot Squaring and Grinding Integrated Machine

晶棒加工耗时（Time）：

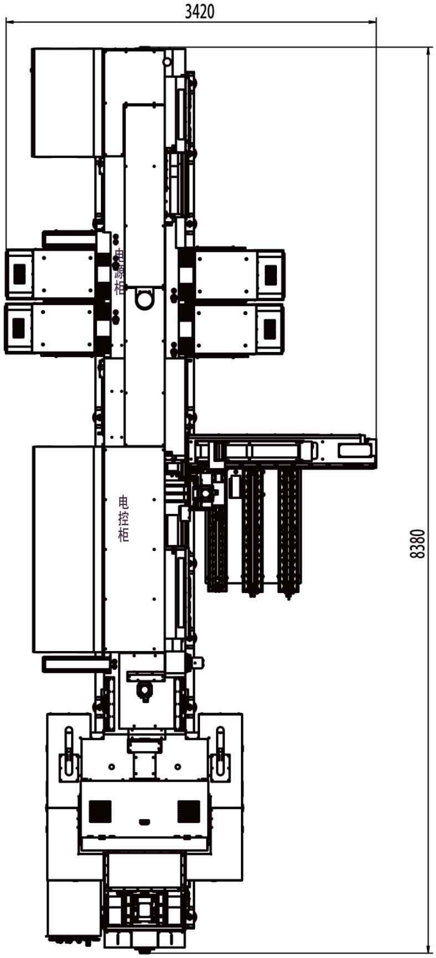
300mm晶棒：单根加工55min，连续加工30min
(Single Ingot：55min/L300mm，
Continuous Process Production：30min/L300mm)

700mm晶棒：单根加工110min，连续加工60min
(Single Ingot：110min/L700mm，
Continuous Process Production：60min/L700mm)

单晶硅棒切磨复合加工一体机是国内首创的一种全自动单晶硅棒切方磨削复合一体加工的设备，该设备集成了原来需要三台不同加工功能设备完成的单晶硅棒边皮切方、平面磨削及外圆磨削等三道加工工序，经过该设备加工后的单晶硅棒主要应用于太阳能光伏电池领域。该设备可满足现代车间的智能化、集成化、自动化的流水线生产的需求。

The domestic initiative – Silicon Ingot Squaring & Grinding Integrated Machine builds in 3 different functions, the silicon ingots after treatment is mainly used in PV field. The machine can meet the needs of moderm workshop of intelligent, Integrated Auto assembly production line.

WCG700-ZJS
单晶硅棒切磨复合加工一体机
Silicon Ingot Squaring and Grinding Integrated Machine



基本尺寸(Basic Size)：

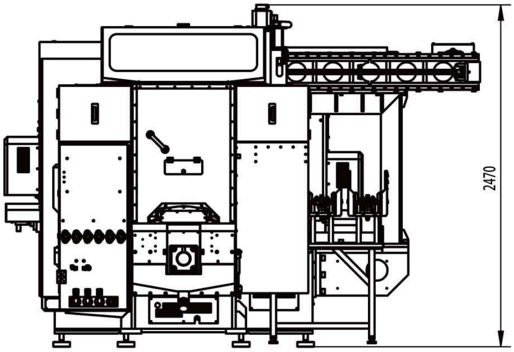
长(Length)：8380mm
宽(Width)：3420mm
高(High)：2470mm
重量(Weight)：约20t

晶棒加工能力(Processing Capability of Ingot)：

长度范围(Grinding Length)：200~700mm
直径范围(Grinding Diameter)：150~230mm
宽度范围(2-Surface Width)：125~156mm

晶棒加工精度(Accuracy)：

宽度(Width)：±0.1mm
对角线(Diagonal)：±0.1mm
锥度(头尾)(Taper (Top to Tail))：<0.06mm
垂直度(Squareness)：90°±0.1°
平面粗糙度(Roughness)：Ra<0.1，Rz<0.7，Ry<0.5



电源(Electrical)：

容量(Capacity)：80kVA
供电电源(Power Supply)：380V，50HZ

冷却水(Coolant Water)：

流量(Flow Rate)：≥60L/min
进水压力(Inlet Pressure)：2.5~3.5 bar
进水温度(Inlet Temperature)：24±1℃

压缩空气(Compressed Air)：

压力(Pressure)：5bar
流量(Flow Rate)：≥200L/min